



SOLLAMID A 2750

PA66 Não Reforçada

DESCRIÇÃO

A família SOLLAMID A caracteriza a Poliamida 66 de baixa viscosidade destinada à moldagem por injeção.

O SOLLAMID A 2750 é a fórmula modificada com aditivos que propiciam uma elevada Resistência ao Impacto.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

As formulas SOLLAMID A 2750 apresentam todas as boas propriedades características da PA 66.

- Excelente Resistência ao Impacto
- Boas Propriedades Mecânicas
- Boa Resistência Térmica até 60 °C contínuos
- Inércia Química
- Facilidade de Moldagem

APLICAÇÕES

A fórmula SOLLAMID A 2750 é indicada para moldagem de componentes submetidas a elevadas solicitações mecânicas, sobretudo impacto em intervalos de temperatura de 23°C a -30°C. Recomendado para componentes que não permitam longo tempo de condicionamento higroscópico.

| CONDIÇÕES DE MOLDAGEM | |
|-----------------------|--------------|
| Zona Alimentação | 250 – 270 °C |
| Zona Fusão | 265 – 280 °C |
| Zona Plastificação | 265 – 280 °C |
| Bico | 80% |
| Temperatura Molde | 60 – 80 °C |



SOLLAMID A 2750

PA66 Não Reforçada

PROPRIEDADES TÍPICAS A 23°C

| | NORMA ASTM | UNIDADE | A 2750 |
|--|------------|-------------------|----------------|
| FÍSICAS | | | |
| Peso Específico | D792 | g/cm ³ | 1,10 |
| Absorção umidade 24h-23°C | D570 | % | 1,00 |
| TÉRMICAS | | | |
| Temperatura de fusão | - | °C | 250-260 |
| Resistência ao calor contínuo | - | °C | 70 |
| Temperatura de deformação sob carga 1,82 MPa | D648 | °C | 70 |
| MECÂNICAS | | | |
| Resistência à tração | D638 | MPa | s 49 |
| Módulo à tração | D638 | MPa | s 2500 |
| Alongamento na ruptura | D638 | % | s >100 |
| Dureza rockwell | D785 | Escala R | s 100 |
| Resistência ao impacto com entalhe Izod | D256 | KJ/m ² | s 68 |
| Charpy | D256 | KJ/m ² | s 82 |
| FLAMABILIDADE UL 94 | 1,6mm | - | V ₂ |
| CONTRAÇÃO NA MOLDAGEM | D955 | % | 1,10-1,50 |

s - corpo de prova seco (0,2% umidade)

Todas as informações são fornecidas de boa fé. Sujeito a alterações sem prévio aviso. Para maiores informações, consulte-nos.